



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

Global Family,
Global Solutions!

環球晶圓 (6488TT)

2024 年第三季營運報告

2024年11月





Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

■

■ ■ ■ ■ ■



01

經營團隊重點報告



經營團隊重點報告

➤ 財務摘要

● 營業收入

- ✓ 2024年第三季 → 新台幣159億元，季增 3.6%，歷年同期第三高！
- ✓ 2024年前三季 → 新台幣463億元，年減少14.1%，歷年同期第三高！

● 營業毛利率

- ✓ 2024年第三季 → 30.0%
- ✓ 2024年前三季 → 32.2%

● 營業淨利率

- ✓ 2024年第三季 → 20.2%
- ✓ 2024年前三季 → 22.8%



➤ 財務摘要

● 稅後淨利率

- ✓ 2024年第三季→ 18.6%
- ✓ 2024年前三季→ 20.2%

● 每股盈餘

- ✓ 2024年第三季→ 新台幣6.18元
- ✓ 2024年前三季→ 新台幣20.19元

● 預收貨款

- ✓ 新台幣331億元 (美金10.5億元)¹

備註：
1. 換算匯率: NTD:USD = 31.65, 含保證金



➤ 產業概況

● 全球經濟

- ✓ 全球經濟成長預期維持溫和，亞洲市場對半導體和人工智慧需求旺盛，伴隨美國經濟回溫，惟歐洲經濟卻面臨挑戰。新興市場則受地緣政治和極端氣候影響，使經濟前景增添不確定性。

● 半導體市場

- ✓ 半導體市場展望：2025年成長將由人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、數據中心及個人電腦所驅動，儘管汽車及工業部門需求較為疲軟。
- ✓ 晶圓市場復甦：半導體晶圓市場呈不均等復甦，先進製程產能受限，惟成熟產能過剩，汽車與消費電子需求疲軟衝擊2024年營收。儘管客戶去庫存化情況改善，惟速度低於預期。

➤ 產業概況

- ✓ 庫存狀況：客戶庫存水位略高於平均，抑制2024年矽晶圓之出貨量，然2025年預計將穩步回升，主因AI需求增長及高階處理需求提升，將進一步推動晶圓廠之稼動率。
- ✓ 資本支出趨勢：隨3奈米以下先進製程與AI技術需求增長，預計帶動半導體廠稼動率持續增長。環球晶圓已策略性地將資本支出集中於先進及特殊製程產品，以掌握市場成長動能。

● 化合物半導體市場

- ✓ 碳化矽市場展望：碳化矽市場目前面臨電動車市場增速放緩、供給過剩，以及價格競爭等挑戰，未來可能出現產業整併。環球晶圓憑藉其財務韌性、有效供應鏈管理及優異品質，在具挑戰的市場環境中維持競爭力。

● 全球擴廠計畫

- ✓ 美國擴廠更新：GlobalWafers America (GWA) 的Greenfield旗艦廠建設進度如期進行。此外，美國財政部及國稅局(IRS)已根據《先進製造業投資稅收抵免法》(Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)確認，半導體製造可享有25%之稅賦減免。環球晶圓旗下 GWA 及 MEMC LLC 亦受惠於此獎勵措施。這些獎勵及直接補助金將有助優化公司資源配置，為在美國市場的持續成長奠定基礎。



02

產業概況



全球GDP成長預測

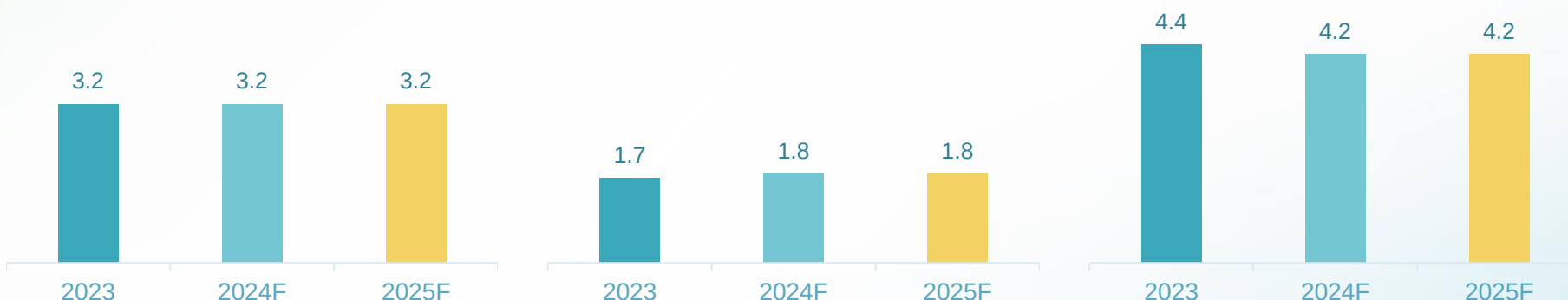
- 全球增長預計在2024年及2025年達3.2%。美國成長上修抵銷主要歐洲國家等先進經濟體下滑。新興市場則面臨地緣政治及極端氣候等挑戰，而半導體需求及人工智慧投資則為新興亞洲增添成長動能。
- 未來經濟前景仍充滿不確定性，當前金融市場波動及地緣政治分裂局勢，將伴隨風險及長期增長機會。

全球市場經濟體

(單位: %)

先進市場經濟體

新興市場與&發展中經濟體

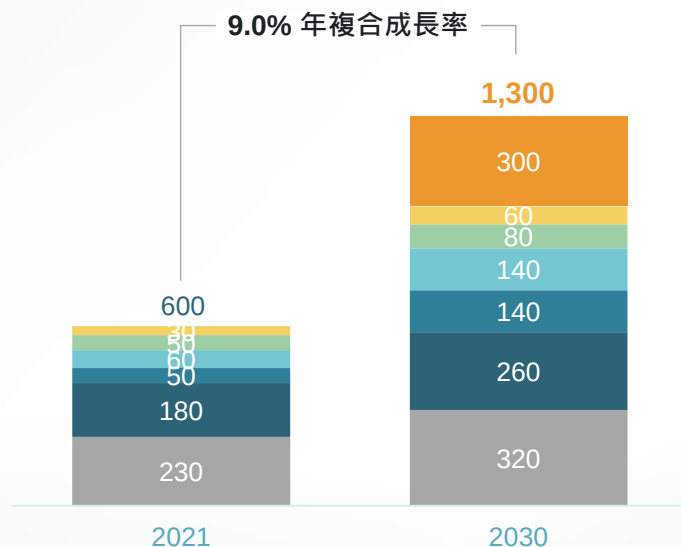


資料來源: 國際貨幣基金組織(IMF), 2024/10

全球半導體市場預估

- 受惠於人工智慧的發展、雲端運算及無線通訊的強勁需求，McKinsey將2030年的半導體市場規模預測由原先**1兆美元上調至1.3兆美元**。
- 2023年12吋矽晶圓出貨量出現下滑，預計2024年將保持平穩，並於2025年進一步成長，主要得益於產能的增加、產能利用率的提高以及需求的逐步復甦。

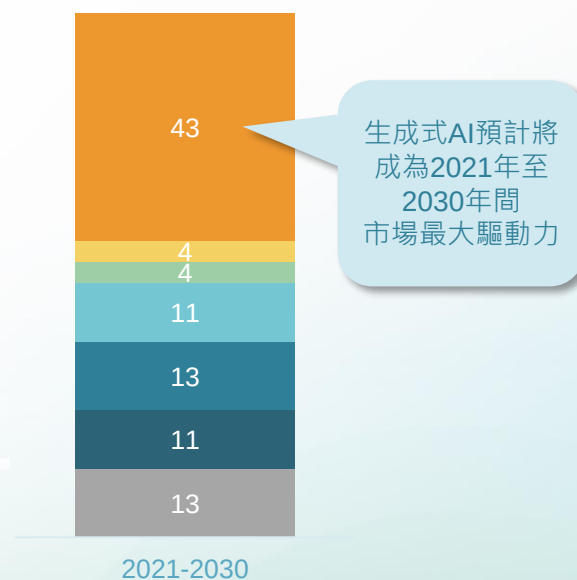
全球半導體市場預測
十億美元



資料來源：
1. McKinsey & Company, 2024/9
2. OMDIA, 2024/9



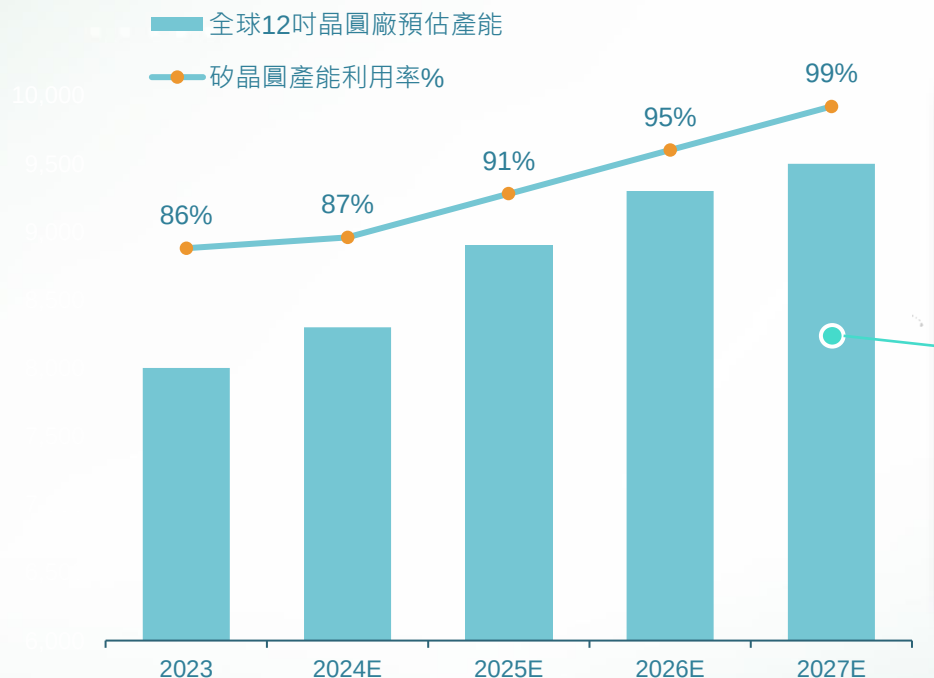
全球市佔率預測, %



12吋矽晶圓產能

- 2025年至2027年，12吋矽晶圓產能利用率預計將超過90%，主要係受到下游需求的推動，亦與上游生產狀況相互呼應。
- 預估2025年至2027年，產能利用率將高達90%至95%，並於2027年達到近乎滿載的狀態。

全球12吋晶圓廠預估產能vs
矽晶圓產能利用率, (KWFS / 月 vs %)

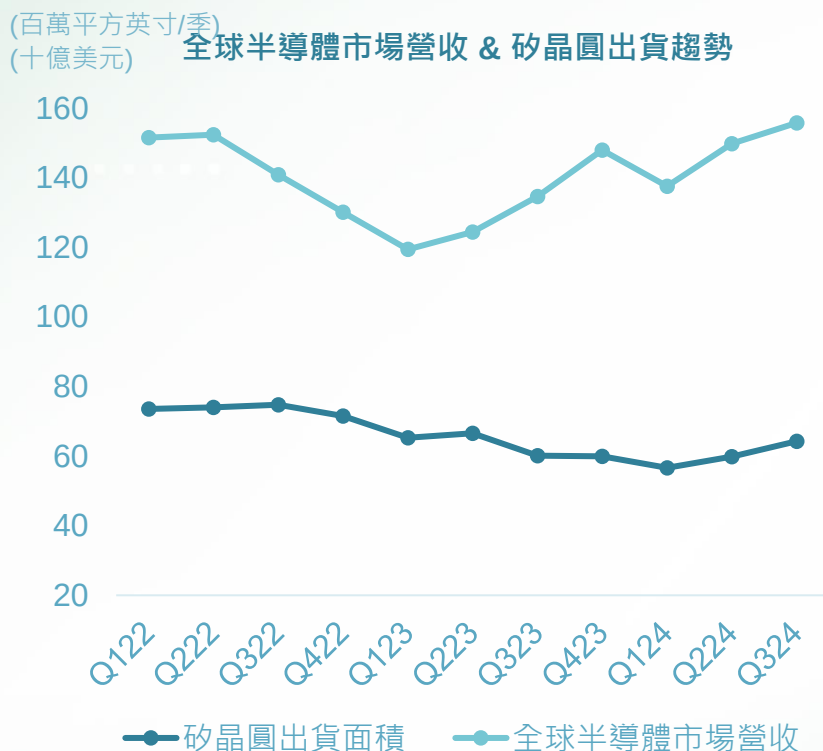


環球晶圓擴產計畫
(12吋晶圓廠)



全球半導體市場客戶庫存趨勢

- 全球半導體市場營收於最近季度出現上升趨勢，然各區域出現不均等復甦。上游矽晶圓市場之出貨量亦開始顯示復甦跡象，惟通常較下游客戶延後約一至兩個季度。
- 儘管全球客戶營收於2024年第3季有所回升，客戶平均庫存天數 (DOIs) 下降速度仍較預期緩慢，顯示終端市場在逐步復甦下，庫存仍需加強去化，尤其是車用電子和工業電子。



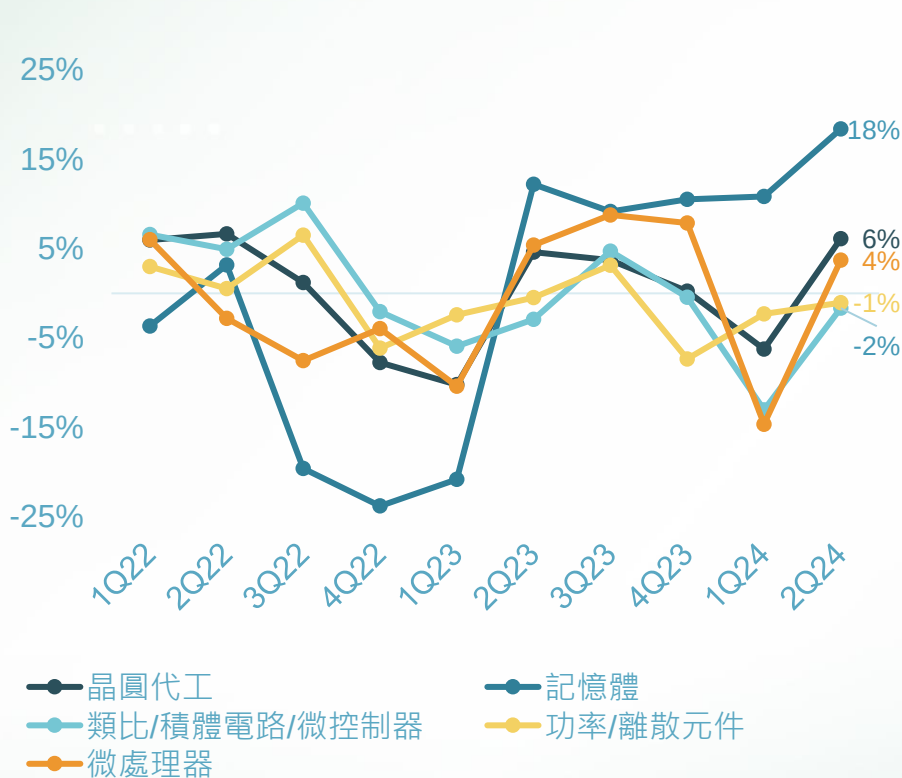
資料來源：世界半導體貿易組織 (WSTS)、矽產品製造商組織 (SMG)

Note: 1. 依據GWC截至2024年10月之現有客戶; 2. 依據GWC截至2024年10月之現有客戶, 庫存僅包括完成品。

全球半導體市場營收表現(依市場及地區區分)

- 不同技術節點之稼動率呈現差異，先進製程面臨產能短缺，惟成熟製程出現產能過剩。儘管記憶體、晶圓代工和微處理器 (MPU) 市場均有增長，類比/積體電路 (Analog/IC) 和功率元件 (Power) 市場則表現不一，顯示各市場不均衡的成長。
- 台灣和韓國呈現成長，然歐洲和日本復甦跡象並不明顯。

環球晶圓全球客戶季營收表現 (依市場)¹



環球晶圓全球客戶季營收表現 (依地區)¹





03

營運概況



財務摘要：2024年第三季 vs. 2024年第二季 vs. 2023年第三季

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2024年第三季	2024年第二季	2023年第三季	季成長	年成長
營業收入	15,870	15,326	17,376	3.6%	-8.7%
營業毛利 %	30.0%	32.3%	36.6%	-2.3p.p.	-6.6p.p.
營業淨利	3,200	3,367	4,825	-4.9%	-33.7%
營業淨利 %	20.2%	22.0%	27.8%	-1.8p.p.	-7.6p.p.
本期淨利	2,952	2,879	5,538	2.6%	-46.7%
本期淨利 %	18.6%	18.8%	31.9%	-0.2p.p.	-13.3p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$6.18	NT\$6.02	NT\$12.73	NT\$0.16	-NT\$6.55
EBITDA* ²	5,024	4,600	8,224	9.2%	-38.9%
EBITDA %	31.7%	30.0%	47.3%	1.7p.p.	-15.6p.p.
EBIT ³	2,922	2,614	6,510	11.8%	-55.1%
股東權益報酬率 /ROE* ⁴ (年化)	12.8% ⁴	14.2%	35.4%	-1.4p.p.	-22.6p.p.
資產報酬率 /ROA* ⁵ (年化)	5.4% ⁵	5.6%	12.7%	-0.2p.p.	-7.3p.p.
資本支出 ⁶	14,699	12,699	10,074	-	-
折舊費用	2,097	1,981	1,709	-	-

1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量
2. EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用
3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息
4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益；Q324 vs. Q323 ROE 下降：主要係因營收下降，本期淨利受到影響，且因現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，導致股東平均權益增加
5. ROA = ((本期淨利 - 利息費用) * (1 - 有效稅率)) / 平均資產；Q324 vs. Q323 ROA 下降：主要係因營收下降，本期淨利受到影響，且固定資產相較於Q224增加，導致平均資產增加
6. Capex = 期末固定資產 - 期初固定資產 + 折舊



財務摘要：2024年前三季 vs. 2023年前三季 (累計)

(單位: 新台幣百萬元，除每股盈餘)	2024前三季	2023前三季	年成長
營業收入	46,283	53,888	-14.1%
營業毛利 %	32.2%	38.3%	-6.1p.p.
營業淨利	10,534	16,137	-34.7%
營業淨利 %	22.8%	29.9%	-7.1p.p.
本期淨利	9,364	15,328	-38.9%
本期淨利 %	20.2%	28.4%	-8.2p.p.
每股盈餘 ¹	NT\$20.19	NT\$35.22	-NT\$15.03
EBITDA ^{*2}	15,506	23,822	-34.9%
EBITDA %	33.5%	44.2%	-10.7p.p.
EBIT ³	9,561	18,869	-49.3%
股東權益報酬率 /ROE ^{*4} (年化)	15.5% ⁴	33.9%	-18.4p.p.
資產報酬率 /ROA ^{*5} (年化)	6.3% ⁵	11.9%	-5.6p.p.
資本支出 ⁶	37,836	24,184	-
折舊費用	5,929	4,939	-

1. EPS = 歸屬於母公司淨利 / 期間內平均已發行普通股數量

EBITDA = 本期淨利 + 所得稅 + 利息 + 折舊費用 + 攤銷費用

3. EBIT = 本期淨利 + 所得稅 + 利息

4. ROE = 本期淨利 / 股東平均權益；2024 前三季 vs. 2023 前三季 ROE 下降：主要係因營收下降，本期淨利受到影響，且因現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，導致股東平均權益增加

5. ROA = ((本期淨利 - 利息費用) * (1 - 有效稅率)) / 平均資產；2024 前三季 vs. 2023 前三季 ROA 下降：主要係因營收下降，本期淨利受到影響，且固定資產相較於2023 前三季增加，導致平均資產增加

6. Capex = 期末固定資產 - 期初固定資產 + 折舊

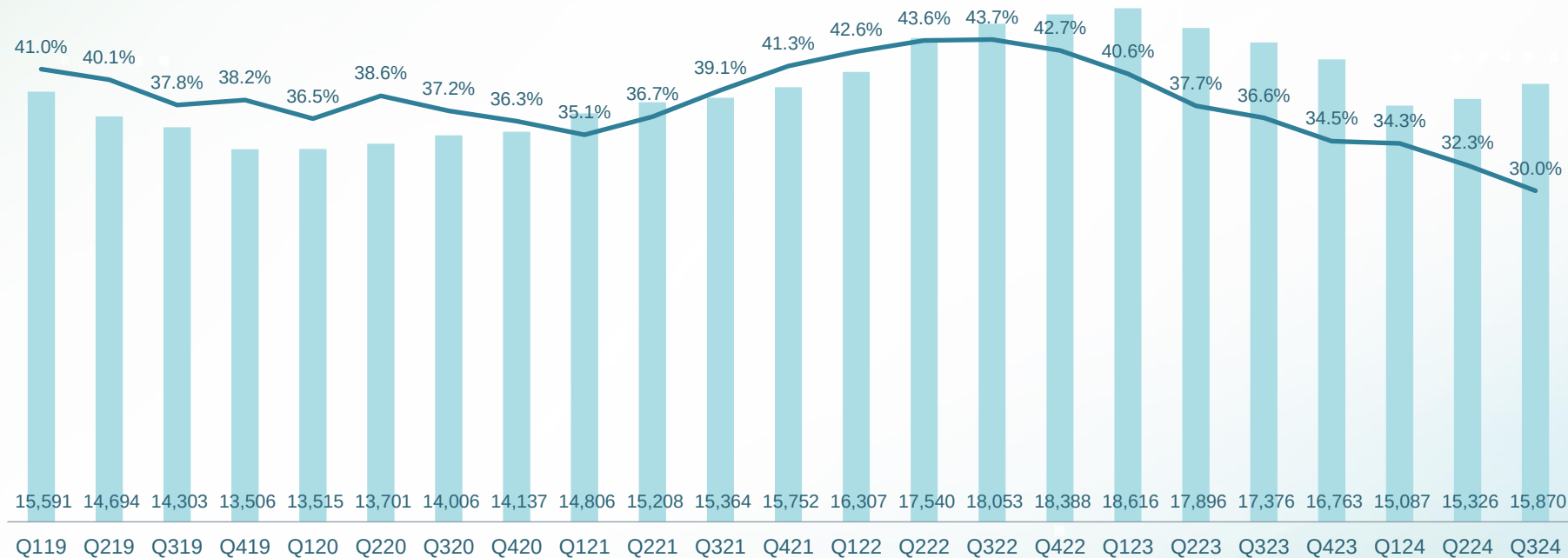


營業收入 & 營業毛利率(%)

營業收入 & 營業毛利率(%)

(新台幣百萬元)

營業收入 營業毛利率 %



備註:

1. Q324毛利降低：主因折舊費用增加、碳化矽(SiC)產品銷量及價格下跌、產品組合差異，以及全球多處地區高溫天氣導致電力成本上升所致

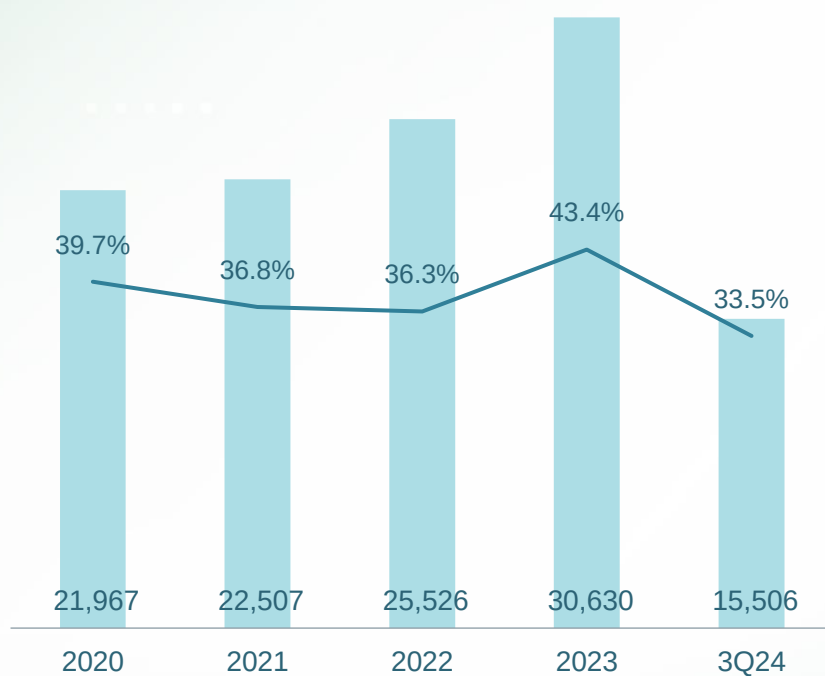


EBITDA & 每股盈餘

EBITDA

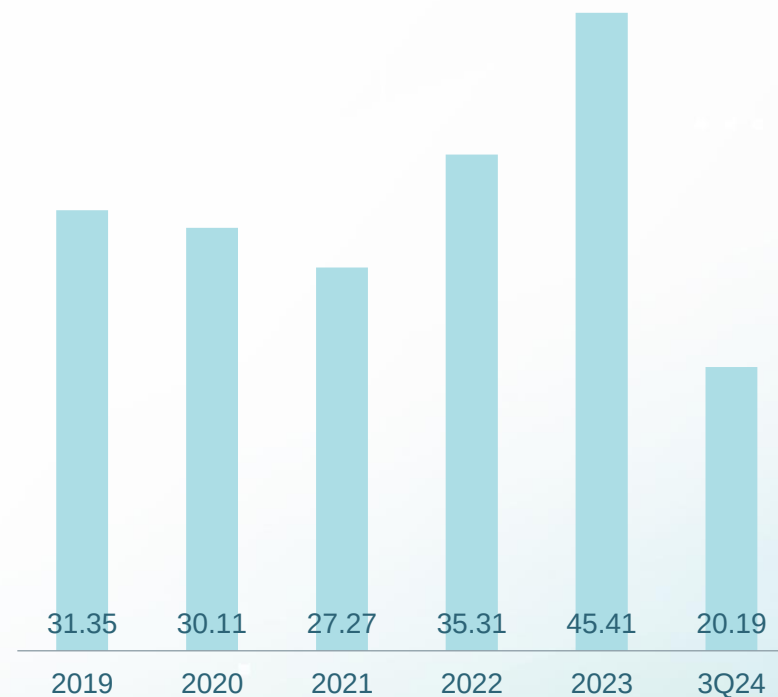
(新台幣百萬元)

■ EBITDA — EBITDA / 營業收入



每股盈餘

(新台幣元)





損益表

損益表

(新台幣百萬元)	2023	Q124	Q224	Q324	3Q24 (Acc.)
營業收入	70,652	15,087	15,326	15,870	46,283
成長率 (%)	0.5%	-10.0%	1.6%	3.6%	-14.1%
營業毛利	26,441	5,168	4,951	4,767 ¹	14,886
營業毛利率 (%)	37.4%	34.3%	32.3%	30.0% ¹	32.2%
EBITDA	30,630	5,882	4,600	5,024	15,506
EBITDA率 (%)	43.4%	39.0%	30.0%	31.7%	33.5%
營業淨利	20,059	3,968	3,367	3,200	10,534
營業淨利率 (%)	28.4%	26.3%	22.0%	20.2%	22.8%
稅前淨利	26,496	4,558	3,531	3,543	11,633
稅前淨利率 (%)	37.5%	30.2%	23.0%	22.3%	25.1%
稅後淨利	19,770	3,533	2,879	2,952 ³	9,364
稅後淨利率 (%)	28.0%	23.4%	18.8%	18.6% ³	20.2%
每股盈餘 (NT\$)	45.41	8.10	6.02	6.18 ³	20.19 ³

備註：

1. Q324毛利降低：主因折舊費用增加、碳化矽(SiC)產品銷量及價格下跌、產品組合差異，以及全球多數地區高溫天氣導致電力成本上升所致
2. 迴轉海外子公司盈餘不匯回之遞延所得稅負債
3. 由於增資關係，股數採用加權平均計算，因此每股盈餘並非恆等式



資產負債表

資產負債表

(新台幣百萬元)

	2022	2023	Q124	Q224	Q324
資產					
現金及約當現金	80,491	26,165	35,672	44,178	41,728 ¹
應收帳款	10,160	10,116	10,061	9,783	9,881
存貨	8,535	9,359	10,737	11,056	12,134 ²
不動產、廠房及設備	39,487	72,251	82,399	94,434	107,335
其他資產	30,823	71,097	63,914	75,373	59,055 ³
資產總計	169,496	188,988	202,783	234,825	230,134

負債

短期借款	6,544	40,000	36,630	45,786	44,035
應付帳款	4,176	5,027	5,189	4,049	4,526
長期借款	42,780	14,542	29,007	28,664	28,531
其他負債	61,672	62,966	60,436	65,537	58,635 ⁴
負債總計	115,172	122,534	131,262	144,036	135,726

權益總計

54,324 66,454 71,521 90,789 94,407⁵

現金資產細項包含：

(新台幣百萬元)

Q324

三個月以上定存	12,944 ⁶
受限制現金	13,508

備註：

1. Q324現金及約當現金減少：主要係發放現金股利
2. Q324存貨增加：主要係為因應廠區歲休安排，提前準備庫存，以致成品庫存增加
3. Q324其他資產減少：主要係以三個月以上定存減少，用於償還銀行借款
4. Q324其他負債減少：主要係應付股利及應付設備款減少
5. Q324股東權益增加：主要係因2024年前3季獲利及美元升值所認列之兌換利益
6. Q324三個月以上定存減少：主要係用於償還因擴廠所增加之銀行借款



04

Q&A



GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司



Thank You



Learn More on
Our Website